

平成 16年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 15年 11月 21日

上場会社名 株式会社東京精密

上場取引所 東

コード番号 7729

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.accretech.jp/)

代表者 代表取締役会長 C.E.O. 大坪 英夫

問合せ先責任者 取締役業務会社執行役員社長 太田 邦正

TEL (0422) 48 - 1011

中間決算取締役会開催日 平成 15年 11月 21日

米国会計基準採用の有無 無

1. 15年 9月中間期の連結業績(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 15年 9月 30日)

(1) 連結経営成績

(百万円未満は切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 9月中間期	25,909	10.8	1,345	249.6	1,001	-
14年 9月中間期	23,393	19.9	384	46.1	39	94.8
15年 3月期	47,171	38.5	1,860	-	1,259	-

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
15年 9月中間期	259	-	6	93	6	93
14年 9月中間期	871	-	23	31	-	-
15年 3月期	74	-	1	64	1	64

(注) 持分法投資損益 15年 9月中間期 - 百万円 14年 9月中間期 - 百万円 15年 3月期 - 百万円
 期中平均株式数(連結) 15年 9月中間期 37,355,775 株 14年 9月中間期 37,370,492 株 15年 3月期 37,364,354 株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期(前期)増減率

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年 9月中間期	90,311	33,621	37.2	900 05
14年 9月中間期	85,775	33,652	39.2	900 53
15年 3月期	88,669	33,645	37.9	900 32

(注) 期末発行済株式数(連結) 15年 9月中間期 37,355,311 株 14年 9月中間期 37,369,835 株 15年 3月期 37,355,873 株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
15年 9月中間期	970	923	1,145	7,376
14年 9月中間期	17	1,121	1,414	6,307
15年 3月期	3,193	4,312	1,248	6,193

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 0 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規)0 社 (除外)0 社 持分法(新規)0 社 (除外)0 社

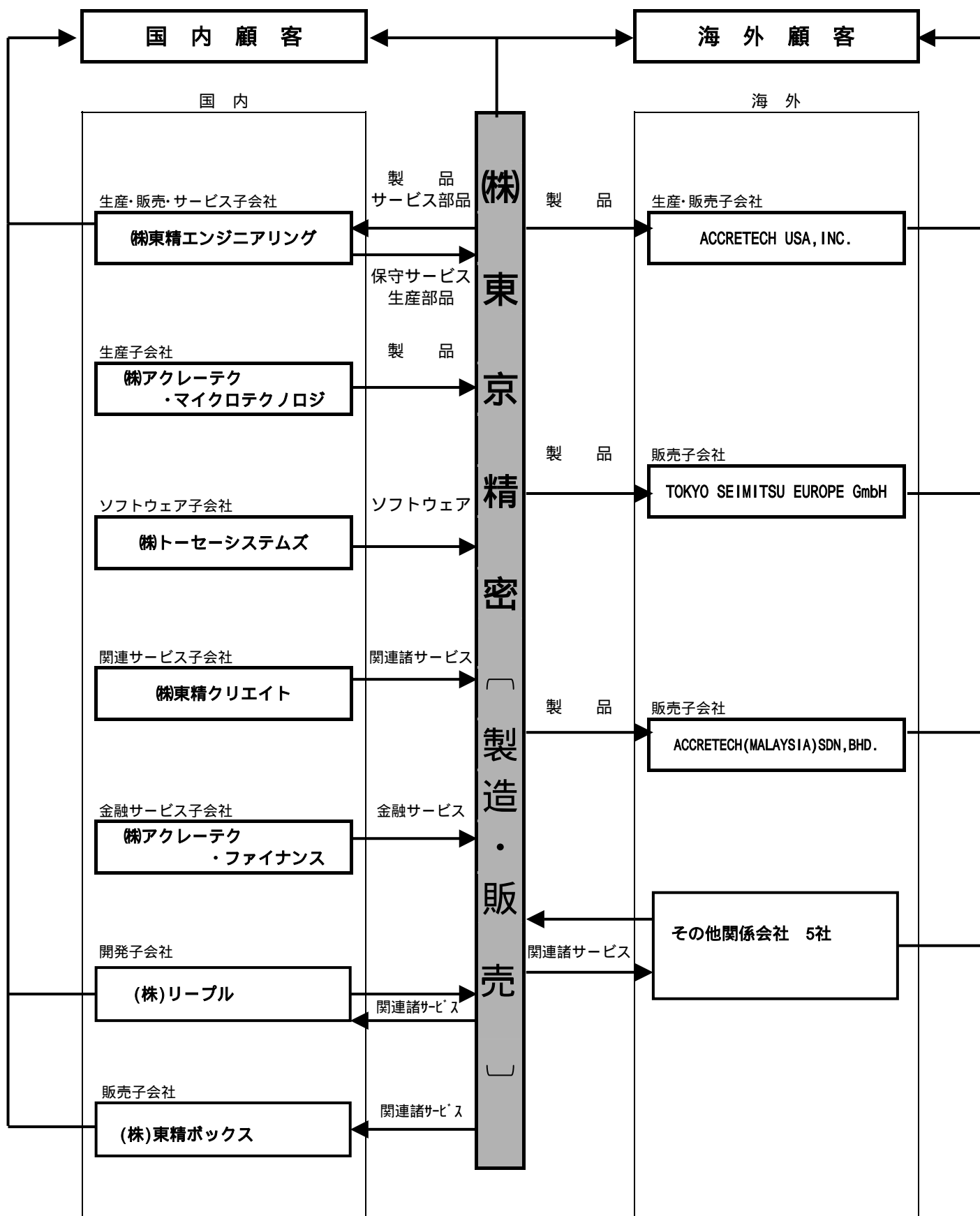
2. 16年 3月期の連結業績予想(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

通期	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
	60,000	4,100	2,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 53 円 54 銭

上記の予想は、添付資料8, 9ページの通期の見通しを前提としております。

1 . 企業集団の状況



2 . 経営方針

(1) 基本方針

当社は、精密計測機器及び半導体製造用機器メーカーとして、常にお客様の高生産性に寄与する最先端技術を駆使した製品開発とカスタマーサポートに注力してまいりました。技術革新が高レベルかつ高スピードで進行する環境下、当社が発展し続けるために最も重要な事は、強い製品開発体制と適正な製品開発基準を持つことです。そこで、以下に掲げる「製品開発の原則」を当社の経営の大原則として、市場の設備投資動向の影響を最小限に抑えつつ、高成長・高収益のビジネス基盤を構築し、さらなる企業価値向上に努めております。

「製品開発の原則」

世界 No.1 の製品を創る

マーケットシェア No.1 の商品は、

(a) 好況時の利益の極大化がはかれる

(b) 不況時の損失の極小化がはかれる

研究開発投資は自己資金で

技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う

相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する

また、「WIN - WIN の仕事で世界 No.1 の商品を創ろう」を当社の行動指針として制定し、「製品開発の原則」遵守を徹底して推進しております。世界 No.1 の製品開発には、各分野における最先端の技術とスピードが要求されます。そのためには、当社の培ってきたコア・テクノロジーを応用することに加え、国内外の垣根を越えて、世界 No.1 の製品創りという共通目的をもつ会社および個人と“WIN - WIN”の協力関係を築くことが不可欠です。各国、各社のもつ異文化を融合したグローバルかつハイブリッドな社風を醸成することにより、世界 No.1 の製品開発体制を構築して、真のグローバル・カンパニーとなるべく努力しております。

当社のコーポレートブランド「ACCRETECH (アクレーテック)」は、「ACCRETE (= Grow Together の意味) + TECHNOLOGY」の合成語で、世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界 No.1 の商品を創り、皆様とともに大きく成長していくという当社の企業理念を一語で表わしたものです。

(2) ユニークな開発体制

当社は、1988 年より各技術開発グループを製品群別に分け、グループリーダーをヘッドとするグループリーダー制を採用しています。グループリーダーは、製品開発のみならず、担当する製品群の業績全般についての責任をもち、事業計画作成、設備投資および人材の採用など大きな権限を与えられています。

2002 年 4 月、当社の執行役員制導入に伴い、グループリーダーは、執行役員に選任されました。これにより、グループリーダー制の備えている、開発計画などのスピーディな意思決定や市場動向への迅速・柔軟な対応という長所が一層強化されました。

(3) 利益配分に関する基本方針

当社は、成長分野において、最先端技術を駆使した世界 No.1 商品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様へ利益還元を図りたいと考えております。配当につきましては、将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、株主の皆様の長期的視点を重視した安定的な配当を実施してまいりたいと考えております。

内部留保金につきましては、当社が成長していくために不可欠な研究開発投資、生産設備投資などに有効に活用してまいりたいと存じます。

(4) 目標とする経営指標

当社は、株主の皆様が当社株式を所有する目的に沿った経営を行っております。従って、一株当たり利益の長期的な上昇とその結果としての企業価値の長期的な上昇を、経営上の重要な指標と考えています。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、前記の基本方針・開発体制に基づき、「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」・「CMP 装置」および「LEEPL 転写装置」など、技術参入障壁が高く競争が少なく、マーケットも大きい、高機能・高価格の新製品を開発してきました。これらの新製品群は、いずれも当社従来製品に比して、数十倍も高い価格の製品であります。

「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」は、2000 年度に市場投入後、お客様の評価も年々たかまり、ビジネスとして順調に成長し、当中間期売上高は前年同期比約 60%増を達成しています。

一方、「CMP 装置」と「LEEPL 転写装置」につきましては、「CMP 装置」が 2002 年度、「LEEPL 転写装置」が 2003 年度からの市場投入となり、今後本格的にビジネスが立ち上がり、業績への貢献が期待されます。

半導体製造装置の市況は、2003 年度下期以降急速に好転し、2004 年度～2005 年度に大きく伸長すると見込まれておりますが、2000 年度の前回ピークには達しないと予想されています。この中において、当社は、既存製品に加え新製品群の売上・収益を拡大させることにより、2004 年度に業績の既往ピーク更新を目指しています。

さらに、より長期（10 年以上）のことを考えますと、当社の従来製品（計測製品、ブローピングマシン、ダイシングマシンなど）が、将来、中国製品と競争する厳しい状況におかれることも想定しておく必要があります。当社は、高機能・高価格で競争の少ない新製品群の開発が長期的な対中国シフトの観点からも重要と考え推進しているものであります。

(6) 会社の対処すべき課題

新製品事業の成功

当社は、ここ数年来、半導体新製品群の開発を積極的に進めてきましたが、「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」は、既にビジネスとして軌道に乗り、予定通りマーケットシェアを拡大し、これらによる新製品群の売上高は、計測部門に匹敵する規模になりました。

今後は、「CMP 装置」・「LEEPL 転写装置」についても、計画通りに開発・生産・販売・サービスを推進し、事業を成功させ、業績の進展に貢献させることが肝要と考えています。

財務構成の改善

当社は、2001 年のシリコンサイクルの落込みによるブローバの在庫増と新製品関連資産の増加などにより、財務諸比率（自己資本比率など）が低下してまいりましたが、ブローバの在庫増は 2002 年度で解消しましたし、新製品につきましても、2002 年度より良くなり始めた資産回転率が 2003 年度上期にさらに改善されました。下期以降、財務諸比率はより良化していく見込みです。

新製品群の販売が拡大している成長期の当社の場合、今後 1～2 期は、財務諸比率の緩やかな改善を甘受しなければなりません。数年後には、新製品群のフリーキャッシュフローのプラスと今年 10 月に発行した転換社債型新株予約権付社債の資本への転換により、財務諸比率が格段に良くなる見通しです。

(7) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその施策の実施状況

<コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方>

企業の経営環境が目覚ましい変化を遂げる中、持続的な成長と発展を実現するには、変化のスピードに対応できる経営体制の構築と、経営の国際標準化と株主重視経営に適合したコーポレートガバナンスの充実が不可欠と認識しております。

<コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況>

執行役員制とカンパニー制の導入

当社は、2002年4月に執行役員制と社内カンパニー制を導入し、社内を半導体社、計測社、業務会社の3つのカンパニーに分けました。全てのオペレーションは、この3社で行うこととし、head office としての機能は廃止いたしました。

半導体社と計測社は、完結した組織として、夫々のお客様に一層機動的かつ迅速に対応できるように、業務会社は、間接部門の合理化を推進しております。

また、2003年4月にトップマネジメントを改正し、会長 C.E.O. と社長 C.O.O. を分離いたしました。会長 C.E.O. は中長期の経営戦略に係わるものに専念し、日常の業務は各カンパニーの社長に委譲され、社長 C.O.O. が全社的な業務執行責任を負うこととなり、経営執行体制がより明確になりました。

コーポレートガバナンスの実効性確保

A. 社内カンパニー制の導入に伴い、株式会社東京精密は、理論的には取締役会のみになります。取締役会は、会社の重要な業務執行について決定したり、取締役の職務執行を監督する機関ですが、当社の取締役は出身企業が多岐にわたり、様々な会社で経験を重ねた人が取締役会を構成しており、当社の取締役会はハイブリッドな組織となっております。

B. 当社の監査役は、当社の大株主出身の経営者で構成されており、3名のうち2名が社外監査役であります。当社監査役は、報酬委員会および経営諮問委員会のメンバーを兼務し、役員の報酬その他、経営の妥当性の判断も行っています。

C. 以上のように当社の取締役会および監査役会のシステムは、日本、米国、ドイツのコーポレートガバナンスの長所をミックスした制度になっています。従って、当社のコーポレートガバナンスは、極めて透明性が高く、accountability が明確であります。

3 . 経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

当中間期の概況

[業績全般]

当中間期の半導体業界は、デジタルカメラや DVD をはじめとするデジタルコンシューマ機器の好調やカメラ付携帯電話の普及さらにパソコンの需要回復などにより、企業収益の改善や生産・設備投資の回復が鮮明になりつつあります。

これを反映して、当社半導体製造用機器部門の市況も回復傾向の中で推移し、半導体既存製品、半導体新製品とも前年同期比増収となり、利益面でも前年同期比大幅改善となりました。

計測機器部門につきましても、日本経済が景気回復の兆しを見せるなか、国内市況が自動車関連産業を中心に順調に回復しておりますし、アジア・アメリカ等海外向けも着実に伸長したことから、前年同期比増収増益を達成しました。

この結果、当中間期の連結売上高は 259 億 09 百万円（前年同期比 10.8%増）、連結経常利益は 10 億 01 百万円、連結中間純利益は 259 百万円となりました。

[各部門の概況]

A．半導体製造用機器部門

- (a) 当社は、回復基調にある国内外の半導体メーカーの設備投資動向を的確に捉え、ニーズに応えるきめ細かい営業を展開しました結果、今期の売上高は 185 億 65 百万円（前年同期比 9.2%増）を達成いたしました。

地域別に見ますと国内、韓国および東南アジアが好調で、アメリカや SARS の影響を受けた台湾が低調でありました。しかし、上期終盤からアメリカ、台湾とも急速に市況は活発化しており、下期以降大幅な伸びが期待されます。

利益面では、固定費削減、変動比率の引き下げなどの強力なコストダウン施策を推進しましたが、CMP 装置などの新製品の費用負担その他により、1 億 37 百万円の営業損失を余儀なくされました。しかし、前年同期比は大幅に改善されており、通期は営業黒字を見込んでおります。

主力既存製品でシェアの高いウェーハプロ - ビングマシンとウェーハダイシングマシンは、市況の回復に比例して、ともに売上が前年同期比順調に増加しています。

前期に販売を開始した 300mm 対応の第三代機となるウェーハプロ - ビングマシンの最新鋭機種「UF3000」は、システム LSI などの多品種少量生産から、メモリなどの大量生産まであらゆるデバイスメーカーのニーズをカバーするフルオートタイプの超高性能プロ - ビングマシンで、お客様から CoO と OEE（設備総合効率）の両面で高い支持を得ており、着実に販売を伸ばしています。

ウェーハダイシングマシンにつきましても、300mm 対応の「A - WD - 300T」が生産性の高いマシンとして機能を高く評価され、売上が堅調に推移しております。

ウェーハ外観検査装置では、前期に新しく発売した「WIN - WIN50 1200」が、高感度・高スループットのマシンとして評価が高まっており、売上が前年同期比大幅に伸長しています。

ポリッシュ・グラインダ「PG200」・「PG300」は、ウェーハの薄片化とダメージ除去を 1 台で実現している他に追随を許さない当社独自の製品で、内外に顧客層を急拡大させており、前年同期比大幅増収となりました。

また、CMP 装置「A - FP - 210A」につきましては、下期に前期比倍増以上の売上が計画しています。

- (b) 研究開発につきましても、300mm ウェーハへの移行や微細化が進展するなかで、300mm 対応機種をはじめ、市場ニーズに適合する次世代装置のタイムリーな開発に注力しております。

ダイシングマシンでは、浜松ホトニクス株式会社と業務提携し、同社が開発したステルスダイシング技術を使って、ウェーハ表面に損傷を与えず、洗浄不要、完全ブレードレスで、チップ分割を行う新型レーザダイシング装置「MAHOHDICING Machine」の開発を進めており、下期に市場投入を予定しています。

ウェーハ外観検査装置では、当社と株式会社日立ハイテクノロジーズが共同開発した 90nm ノード以降に対応できる「HA - 3000 ウェーハ外観検査装置」が、下期より本格的に販売展開される見込です。

子会社の株式会社リープルが進めている 100nm ~ 35nm の微細回路製造用転写装置「LEEPL 転写装置」の開発は順調で、現在、国内数社・海外数社と具体的な「LEEPL 転写装置」導入に向けて評価等を進めており、下期に量産 1 号機の販売を目指しています。

また、2001 年 6 月、当社、株式会社リープル、ソニー株式会社の 3 社が、次世代リソグラフィ技術の開発促進と普及を目的に、各業界に呼びかけて、「LEEPL 技術コンソーシアム」を発足させました。当初、半導体デバイスメーカー、装置メーカー、マスクメーカー、レジストメーカーの 13 社で発足しましたが、その後加入企業が増加し、現在では 31 社が活動しています。

「LEEPL 転写装置」は、次世代リソグラフィの本命として脚光を浴びておりますが、リープル技術およびマスク、レジストなどの周辺技術の開発は確実に進展しており、今後リープル事業が当社のコア事業に成長していくものと予想しております。

また、当社は、LEEPL 技術の開発・促進に必要なステンシルマスク専用の「マスク欠陥検査装置」につきましても、開発を進めており順調に進捗しています。

B . 計測機器部門

- (a) 計測機器部門につきましては、緩やかに成長する市況のもと、ユーザーニーズを確実に受注に取込む営業努力により、国内・海外とも売上を伸ばすことができ、売上高は 73 億 43 百万円（前年同期比 15.0%増）となりました。

生産面でもコストダウンに注力し、営業利益も 14 億 83 百万円（前年同期比 17.3%増）と増益を達成しました。

汎用計測機器では、世界最高精度を誇る表面粗さ形状測定機「サーフコムシリーズ」や高精度で好評の真円度測定機「ロンコムシリーズ」の売上が堅調に推移しました。また、カールツァイス社と提携し、高品質に定評のある三次元座標測定機では、4 月に市場投入した「ザイザックス SVA」シリーズが好調です。

自動計測機器では、「パルコムシリーズ」が自動車関連向けなどに好調でありました。

- (b) 研究開発につきましては、駆動部に初めてリニアモータを採用し、世界最高レベルの測定スピードと低振動を実現した表面粗さ形状測定機「サーフコム 1500DX」と、同じくリニアモータ採用で、高い測定精度を実現した輪郭形状測定機「コンターレコード 1700DX」を開発し、2003 年 4 月より販売開始し、好評を得ております。

また、当社の高剛性設計技術とカールツァイス社の解析・制御技術を融合して、新しく開発した CNC 三次元座標測定機の新シリーズ「ザイザックス SVA」も 2003 年 4 月より販売を開始し、高い評価を得て売上が大幅に伸びています。

[転換社債型新株予約権付社債の発行について]

当社は、2003 年 10 月 6 日に、2008 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 175 億円を発行いたしました。調達資金は、今後ビジネスが伸長する「LEEPL 転写装置」など新製品群の生産拡大のための新工場建設を含めた設備資金および増加運転資金に充当する予定です。

[利益配分について]

当中間期の配当につきましては、前述の利益配分の基本方針と下記理由から当初予定どおり一株当たり 15 円とすることといたしました。

- A．半導体産業は、市況の急進・急落があるので短期の業績を直ちに配当に反映させることは、長期的視点で保有していただいている株主の皆様との視点と合致しないこと。
- B．当社の財務状況と今後のキャッシュフロー、および2003年9月末未処分利益90億47百万円から、一株当り年間30円配当継続には無理のないこと。

通期の見通し

[業績全般および各部門の概況]

A．半導体製造用機器部門

2003年度下期の半導体業界は、円高傾向の懸念材料があるものの、デジタルコンシューマ機器の好調推移やパソコン需要の回復などを背景に、半導体メーカーの設備投資は一段と活発になると見込まれ、概ね当社の期初予想通りであります。

かかる状況下、当社の半導体製造用機器部門の通期業績につきましては、マーケットシェアの高いウエーハプロ・ビングマシンやウエーハダイシングマシンなどの既存製品が、下期は上期より売上が増加する見通しで、通期で前期比2割程度の増加を予定しています。

一方、ユーザー評価が高まっているウエーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダ、CMP装置の新製品群は、引合い・受注動向などより考えて、引続きマーケットシェアを伸ばし、前期比倍増以上の売上を達成できるものと計画しております。

以上より、半導体製造用機器部門の2003年度の売上高は、450億円（前期比34.1%増）を予想しております。

B．計測機器部門

2003年度下期の計測機器部門の市況は、国内外とも引続き緩やかな上昇基調と考えられ、自動車関連の各ユーザーを中心に、堅調な需要が見込まれます。

かかる状況下、お客様のニーズを的確に把握し受注に繋げるとともに、4月より発売した高性能の新製品群も積極的に拡販し、2003年度売上高は、150億円（前期比10.2%増）を予定しています。

以上のような予測の下、2003年度通期の連結売上高、600億円（前期比27.2%増）連結経常利益41億円（同225.5%増）連結当期純利益20億円と予想しており、2000年度のピーク時に対する比率などにおいて、業界水準を上回る売上高・利益を確保できると考えております。

[利益配分について]

期末配当金につきましては、上記業績見通し及び前述の利益配分に関する基本方針に従い、安定的な配当を継続することとし、従来同様一株当たり15円（中間配当金15円と合わせ通期では一株当たり30円）を予定しております。

(2) 財政状態

当中間期末における現金および現金同等物は、前期末より11億円増加し、73億円となりました。当中間期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは9億円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上（9億円）、売上債権の増加（19億円）、および減価償却費（17億円）などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは9億円の支出となりました。これは当社および連結子会社による設備投資支出(9億円)などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、11億円の収入となりました。これは主に、長期借入金の実行(38億円)、短期借入金の返済(6億円)、長期借入金の返済(13億円)および配当金の支払(5億円)などによるものであります。

当中間期の営業キャッシュ・フローは、前年同期に比べ大幅に改善されていますが、下期は新製品の売上拡大や利益計上などにより、さらに営業キャッシュ・フローの好転が見込まれ、社債発行による収入金の有効活用にも留意し、より良い財務状況を構築してまいります。

将来の事象に係る記述に関する注意

この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、ならびに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

4. 比較中間連結貸借対照表

当中間期（平成 15 年 9 月 30 日現在）

前中間期（平成 14 年 9 月 30 日現在）

前 期（平成 15 年 3 月 31 日現在）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

科 目	当中間期	前中間期	前 期	科 目	当中間期	前中間期	前 期
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	60,512	57,550	59,062	流 動 負 債	40,088	36,125	38,964
現金及び預金	7,403	6,334	6,220	支払手形及び買掛金	10,976	9,561	11,245
受取手形及び売掛金	17,940	16,268	16,180	短期借入金	18,795	19,938	19,486
たな卸資産	34,112	33,816	34,075	一年以内返済予定 長期借入金	5,379	2,452	3,297
未収消費税等	-	224	364	一年以内償還予定社債	200	-	200
繰延税金資産	416	311	904	未払法人税等	381	480	598
その他流動資産	676	639	1,356	賞与引当金	643	606	584
貸倒引当金	37	45	40	その他流動負債	3,712	3,086	3,552
固 定 資 産	29,799	28,224	29,606	固 定 負 債	14,652	14,182	14,162
（有形固定資産）	（15,501）	（15,429）	（15,578）	社 債	1,950	250	2,050
建物及び構築物	5,488	6,020	5,762	転換社債	51	51	51
機械装置及び運搬具	3,665	2,946	3,868	長期借入金	8,823	10,420	8,446
工具器具備品	817	761	742	退職給付引当金	3,293	2,931	3,107
土地	2,919	2,916	2,919	役員退職慰労引当金	486	477	461
建設仮勘定	2,609	2,783	2,287	繰延税金負債	47	52	45
（無形固定資産）	（7,097）	（6,257）	（7,580）	負 債 合 計	54,741	50,308	53,126
ソフトウェア	6,453	5,790	6,845				
その他無形固定資産	644	466	735	少 数 株 主 持 分	1,949	1,814	1,897
（投資その他の資産）	（7,200）	（6,538）	（6,447）				
投資有価証券	2,981	2,104	2,407	資 本 の 部			
長期貸付金	380	83	56	資 本 金	7,199	7,199	7,199
繰延税金資産	3,315	3,777	3,426	資 本 剰 余 金	11,806	11,806	11,806
その他の投資	569	643	606	利 益 剰 余 金	14,876	14,806	15,191
その他の資産				その他有価証券評価 差額金	190	292	617
貸倒引当金	46	70	49	為替換算調整勘定	23	145	111
繰 延 資 産	0	0	0	自 己 株 式	48	13	46
社債発行差金	0	0	0	資 本 合 計	33,621	33,652	33,645
資 産 合 計	90,311	85,775	88,669	負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	90,311	85,775	88,669

5 . 比較中間連結損益計算書

当中間期（平成15年4月1日～平成15年9月30日）

前中間期（平成14年4月1日～平成14年9月30日）

前 期（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

科 目		当中間期	前中間期	前 期
経常 損益 の部	営業 売上高	25,909	23,393	47,171
	売上原価	19,910	18,101	35,828
	売上総利益	5,998	5,292	11,343
	販売費及び一般管理費	(4,652)	(4,907)	(9,482)
	販売費	3,523	3,743	7,229
	一般管理費	1,128	1,163	2,253
	営業利益	1,345	384	1,860
	営業外収益	(94)	(82)	(297)
	受取利息	2	3	7
	受取配当金	11	12	136
その他	79	66	153	
営業外費用	(438)	(427)	(897)	
支払利息	153	132	279	
為替差損	264	277	500	
その他	21	17	118	
経常利益	1,001	39	1,259	
特別 損益 の部	特別利益	(198)	(-)	(123)
	投資有価証券売却益	66	-	-
	その他	132	-	123
	特別損失	(205)	(1,263)	(1,307)
	たな卸資産評価損	-	903	903
	投資有価証券評価損	-	170	22
	その他	205	189	381
税金等調整前中間（当期）純利益 又は純損失		994	1,223	75
法人税、住民税及び事業税		372	369	694
法人税等調整額		264	842	908
法人税等（計）		636	472	214
少数株主持分利益		98	120	215
中間（当期）純利益又は純損失		259	871	74

6. 比較中間連結剰余金計算書

当中間期（平成15年4月1日～平成15年9月30日）

前中間期（平成14年4月1日～平成14年9月30日）

前期（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

科 目	当中間期	前中間期	前 期
（資本剰余金の部）			
資本剰余金期首残高	11,806	11,806	11,806
資本剰余金期首残高	11,806	11,806	11,806
資本剰余金増加高	-	-	-
資本剰余金減少高	-	-	-
資本剰余金中間期末残高	11,806	11,806	11,806
（利益剰余金の部）			
利益剰余金期首残高	15,191	16,463	16,463
利益剰余金期首残高	15,191	16,463	16,463
利益剰余金増加高	259	-	74
1. 中間（当期）純利益	259	-	74
利益剰余金減少高	573	1,657	1,346
1. 中間純損失	-	871	-
2. 配当金	560	560	1,121
3. 取締役賞与金	12	12	12
4. 連結子会社増加による 利益剰余金減少高	-	212	212
利益剰余金中間期末残高	14,876	14,806	15,191

7. 比較中間連結キャッシュ・フロー計算書

当中間期（平成15年4月1日～平成15年9月30日）

前中間期（平成14年4月1日～平成14年9月30日）

前期（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

勘定科目	当中間期	前中間期	前期
営業活動キャッシュ・フロー			
税金等調整前中間（当期）純利益又は純損失	994	1,223	75
減価償却費	1,730	1,288	2,579
連結調整勘定償却額	40	40	80
退職給付引当金の増加額	186	137	312
役員退職慰労引当金の増減額	25	63	79
受取利息及び受取配当金	14	16	143
支払利息	153	132	279
有形固定資産除却・売却損	0	2	48
投資有価証券・ゴルフ会員権評価損	18	170	26
投資有価証券売却益	66	-	-
売上債権の増加額	1,905	4,266	4,142
たな卸資産の増減額	417	89	198
仕入債務の増減額	24	4,615	6,283
取締役賞与の支払額	12	12	12
その他営業活動による収入又は支出	992	618	1,388
小計	1,698	273	3,719
利息及び配当金の受取額	14	16	143
利息の支払額	154	116	261
法人税等の支払額	587	191	408
営業活動キャッシュフロー	970	17	3,193
投資活動キャッシュ・フロー			
定期預金の預入	10	10	20
定期預金の払出	10	10	20
投資有価証券の取得	0	0	703
投資有価証券の売却	218	-	-
関係会社出資金	-	25	41
有形・無形固定資産の取得	1,157	1,114	3,700
有形・無形固定資産の売却	340	2	89
貸付金の実行	338	-	-
貸付金の回収	14	16	43
投資活動キャッシュフロー	923	1,121	4,312
財務活動キャッシュ・フロー			
短期借入金の減少額	650	2,861	3,309
長期借入金の実行	3,800	5,000	5,000
長期借入金の返済	1,341	156	1,284
社債の発行	-	-	2,000
社債の償還	100	-	-
配当金の支払	560	560	1,121
その他財務活動による支出	1	7	35
財務活動キャッシュフロー	1,145	1,414	1,248
現金・現金同等物 換算差額	10	8	40
現金・現金同等物 増減額	1,182	283	170
現金・現金同等物 期首残高	6,193	5,897	5,897
連結子会社増加に伴う現金・現金同等物増加額	-	125	125
現金・現金同等物 期末残高	7,376	6,307	6,193

8 . 中間連結財務諸表作成の基本となる事項

1 . 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社(8社)

(株)東精エンジニアリング、(株)トーセシステムズ、(株)アクレテック・マイクロテクノロジー、(株)東精クリエイト、(株)アクレテック・ファイナンス、(株)リーブル、ACCRETECH USA, INC.、TOKYO SEIMITSU EUROPE GmbH

(2) 非連結子会社(6社)

(株)東精ボックス、ACCRETECH(MALAYSIA)SDN,BHD.、ACCRETECH(ISRAEL)LTD.、ACCRETECH(SINGAPORE)PTE LTD.、ACCRETECH MICRO TECHNOLOGIES KOREA CO.,LTD、東精精密設備(上海)有限公司

連結の範囲から除いた理由は、上記6社いずれも小規模会社であり、合計の総資産・売上高・中間純損益及び利益剰余金の金額がいずれも僅少であり、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないためであります。

2 . 持分法の適用に関する事項

関連会社 三門峡中原精密有限責任公司については、それぞれ中間連結純損益及び連結利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、これらの会社に対する投資については、持分法を適用せず原価法により評価しております。

3 . 連結子会社の中間決算日に関する事項

連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。

4 . 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの……中間連結会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法により算定しています。)

時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しております。

(ロ) たな卸資産

親会社及び国内連結子会社は、商品・製品・材料及び貯蔵品については、先入先出法による原価法、仕掛品については、個別法による原価法であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

親会社及び国内連結子会社は、定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物付属設備は除く)については、定額法によっております。

(ロ) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェアは、見込販売数量に基づく方法又は残存有効期間に基づく定額法によっており、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。その他の無形固定資産は、定額法であります。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生翌連結会計年度より費用処理しております。

(ニ) 役員退職慰労引当金

役員の退任時に支出が予想される役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末支払見込額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

9. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

当中間期(平成15年4月1日～平成15年9月30日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高及び営業損益					
(1)外部顧客に対する売上高	18,565	7,343	25,909	-	25,909
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	18,565	7,343	25,909	(-)	25,909
営業費用	18,703	5,860	24,563	(-)	24,563
営業利益又は営業損失()	137	1,483	1,345	(-)	1,345

前中間期(平成14年4月1日～平成14年9月30日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高及び営業損益					
(1)外部顧客に対する売上高	17,006	6,386	23,393	-	23,393
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	17,006	6,386	23,393	(-)	23,393
営業費用	17,886	5,121	23,008	(-)	23,008
営業利益又は営業損失()	880	1,265	384	(-)	384

前期(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高及び営業損益					
(1)外部顧客に対する売上高	33,561	13,610	47,171	-	47,171
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	33,561	13,610	47,171	(-)	47,171
営業費用	34,583	10,727	45,311	(-)	45,311
営業利益又は営業損失()	1,022	2,882	1,860	(-)	1,860

(2) 所在地別セグメント情報

当中間期 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消却又は全社	連 結
売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	22,446	1,863	1,599	25,909	-	25,909
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	2,203	-	-	2,203	(2,203)	-
計	24,650	1,863	1,599	28,112	(2,203)	25,909
営 業 費 用	23,286	2,015	1,539	26,841	(2,277)	24,563
営業利益又は営業損失 ()	1,364	151	59	1,271	74	1,345

前中間期 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 14 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消却又は全社	連 結
売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	17,179	4,950	1,263	23,393	-	23,393
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	3,357	-	-	3,357	(3,357)	-
計	20,537	4,950	1,263	26,750	(3,357)	23,393
営 業 費 用	20,346	4,910	1,285	26,542	(3,533)	23,008
営業利益又は営業損失 ()	190	39	21	208	176	384

前 期 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 3 月 31 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消却又は全社	連 結
売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	37,268	7,440	2,462	47,171	-	47,171
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	5,910	-	-	5,910	(5,910)	-
計	43,179	7,440	2,462	53,082	(5,910)	47,171
営 業 費 用	41,299	7,796	2,425	51,521	(6,209)	45,311
営業利益又は営業損失 ()	1,880	355	37	1,561	298	1,860

(3) 海外売上高

当中間期 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
海外売上高	5,317	1,608	1,952	1,200	10,078
連結売上高					25,909
連結売上高に占める海外売上高	20.5%	6.2%	7.5%	4.7%	38.9%

前中間期 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 14 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
海外売上高	5,371	4,969	1,358	927	12,627
連結売上高					23,393
連結売上高に占める海外売上高	23.0%	21.2%	5.8%	4.0%	54.0%

前 期 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 3 月 31 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
海外売上高	10,916	7,069	2,826	1,997	22,811
連結売上高					47,171
連結売上高に占める海外売上高	23.2%	15.0%	6.0%	4.2%	48.4%

10. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	当 中 間 期	前 中 間 期	前 期
	自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 15 年 9 月 30 日	自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 14 年 9 月 30 日	自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 15 年 3 月 31 日
半導体製造用機器関連事業	18,393	15,420	32,965
計測機器関連事業	7,366	6,699	14,724
合 計	25,759	22,120	47,689

(注) 金額表示は販売価額(消費税抜き)によっております。

(2) 受注実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	当 中 間 期		前 中 間 期		前 期	
	自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 15 年 9 月 30 日		自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 14 年 9 月 30 日		自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 15 年 3 月 31 日	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半導体製造用機器関連事業	19,840	8,487	17,714	6,429	35,240	7,212
計測機器関連事業	7,853	2,717	6,739	2,164	14,007	2,207
合 計	27,693	11,205	24,454	8,593	49,248	9,420

(注) 金額表示は販売価額(消費税抜き)によっております。

(3) 販売実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	当 中 間 期	前 中 間 期	前 期
	自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 15 年 9 月 30 日	自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 14 年 9 月 30 日	自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 15 年 3 月 31 日
半導体製造用機器関連事業	18,565	17,006	33,561
計測機器関連事業	7,343	6,386	13,610
合 計	25,909	23,393	47,171

(注) 金額表示は販売価額(消費税抜き)によっております。

11. 有価証券の時価等

(1) 有価証券の時価等

時価のある有価証券

(単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示)

区 分	当 中 間 期 (平成15年9月30日現在)			前 中 間 期 (平成14年9月30日現在)			前 期 (平成15年3月31日現在)		
	取得原価	中間連結 貸借対照 表計上額	差 額	取得原価	中間連結 貸借対照 表計上額	差 額	取得原価	連結貸借 対 照 表 計 上 額	差 額
その他の有価証券									
(a) 株 式	2,452	2,145	306	2,143	1,645	497	2,493	1,451	1,041
(b) 債 券									
社 債	-	-	0	40	40	0	40	40	0
計	2,452	2,145	306	2,183	1,686	496	2,533	1,492	1,040

時価のない有価証券

(単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示)

区 分	当 中 間 期 (平成15年9月30日現在)	前 中 間 期 (平成14年9月30日現在)	前 期 (平成15年3月31日現在)
	中間連結貸借対照表計上額	中間連結貸借対照表計上額	連結貸借対照表計上額
その他の有価証券			
(a)非上場株式	836	417	914
計	836	417	914

12. デリバティブ取引の状況

当中間連結会計年度(自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)

該当事項はありません。

13. リース取引関係

当中間期（平成15年4月1日～平成15年9月30日）

前中間期（平成14年4月1日～平成14年9月30日）

前期（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係る注記	当中間期		前中間期		前期	
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間（期末）残高相当額	機械装置及び運搬具	工具器具及び備品	機械装置及び運搬具	工具器具及び備品	機械装置及び運搬具	工具器具及び備品
取得価額相当額	2,085	749	2,016	716	2,085	730
減価償却累計額相当額	570	460	255	315	412	391
中間（期末）残高相当額	1,515	289	1,760	401	1,672	338
(2) 未経過リース料中間（期末）残高相当額						
1年以内	491		457		479	
1年超	1,376		1,742		1,584	
合計	1,867		2,199		2,063	
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額						
支払リース料	285		273		551	
減価償却費相当額	257		245		495	
支払利息相当額	39		45		88	
(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法						
減価償却費相当額の算定方法	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。		同左		同左	
利息相当額の算定方法	リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。		同左		同左	

14. 関連当事者との取引

当中間連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日）

該当事項はありません。